

证券代码：002156

证券简称：通富微电

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	青岛德泽六禾：陈韬；银河证券自营：肖华、邓婷文；第一创业：兰越；德邦资管：白宇；君和资本：宋礼之；华能贵诚信托：陈晨；华融证券股份有限公司：程松涛；上海纯达资产管理有限公司：李竹青；光大永明资产管理股份有限公司：郑舒平；深圳纽福斯投资管理有限公司：连敏超；粤开证券股份有限公司：黄佳佳、时雪琪；国投创益产业基金管理有限公司：付辛凯；山东铁投：刘虔、韩杰；福建高科：黄丹昀；陕旅投资：马璇；陕西石洋投资管理有限公司：孟祺；景林投资：徐伟、孙玮、谢涵韬；奇点投资：谢明；山东国惠：徐庆瑞；青岛平度城投：孙泽宇；中信资管：黄源、丁俊；物产中大：黎毅、李纯莹；华西银峰：唐英培；国海创新资本：钱海霞；盈科资本：范曦临；玄元投资：刘彤；太平资产：施佳欢、应宇翔；睿亿投资：黄文昊；招银理财：王欣
时间	2021年12月30日
地点	电话会议方式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蒋澍
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司概况 通富微电主要从事集成电路封装测试业务，公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石

明达先生，股权结构稳定。

公司抓住行业发展机遇，坚持发展主业的指导方针，注重质量，加快发展，继续做大做强。公司采用自身内涵式发展和兼并重组外延式发展相结合的模式，促进公司产品结构调整和转型升级。公司先后在南通苏通科技产业园、安徽合肥、厦门海沧布局，新建苏通工厂、合肥工厂，并参股厦门工厂，收购了 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85% 股权，公司的主要生产基地从之前的南通崇川总部一处扩张为崇川、苏通、合肥、苏州、马来西亚槟城五处生产基地，并通过参股形式布局厦门，形成多点开花的局面。产能成倍扩大，特别是先进封装产能大幅提升，带来的规模优势更为明显。公司是全球第五大封测企业，市场份额持续提升，行业地位突出。

公司 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年前三季度分别实现营收 72.23 亿元、82.67 亿元、107.69 亿元和 112.04 亿元，2018 年至 2020 年公司营收平均复合增长率 22.10%。公司 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年前三季度的归母净利润分别为 1.27 亿元、0.19 亿元、3.38 亿元和 7.03 亿元，2021 年前 3 季度归母净利润同比增长 168.56%。公司营收规模和盈利能力快速增长，发展势头强劲。

展望未来，随着汽车电子、5G、云计算、物联网、人工智能等创新型应用的不断爆发，半导体行业有望进入高景气周期，公司未来业绩增长动力强劲，有望为投资者带来丰厚的投资收益。

二、行业情况

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。近年来，国家相继出台了若干产业政策，大力支持集成电路产业发展。

在国家政策的大力支持下，近年来我国集成电路市场

保持高速增长。根据中国半导体行业协会统计，从 2011 年到 2020 年中国半导体市场规模从 1,934 亿元扩大至 8,848 亿元，年均复合增长率为 18.41%，明显高于全球半导体市场增速。从下游应用领域来看，通信和消费电子是我国集成电路最主要的应用市场。从细分行业来看，在集成电路行业整体高速增长带动下，我国封装测试行业亦呈现高速增长态势，销售收入由 2011 年的 649 亿元上升至 2020 年的 2,510 亿元，平均复合增长率达到 14.48%。

随着 5G 通讯网络、人工智能、汽车电子、智能移动终端、物联网等技术不断发展，集成电路需求不断扩大。根据 Gartner 预计，2021 年全球集成电路市场增速可达 10%。在全球半导体产业链向中国大陆迁移的大背景下，伴随着国内终端厂商逐渐将供应链向国内转移的趋势，国内封装测试企业面临良好的发展机会。

集成电路是国家需要突破发展的“重点领域”，着力提升集成电路设计水平，提升国产芯片的应用适配能力，提升封装产业和测试的自主发展能力是国家提升科技水平的重要环节。2020 年 8 月，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，进一步强调了快速发展集成电路产业、提高行业竞争力的重要性。随着我国集成电路产业链国产替代的进程不断推进，国内电子产品终端厂商正加快将订单转移给国内集成电路供应商。预计未来一段时间国产芯片的市场需求将快速上升，半导体封测的市场需求也会随之增长。

三、公司发展优势

半导体行业具有导入周期长且准入门槛高的特点，在通过客户验证形成合作后，业务稳定性较强且客户粘性较大，通富微电经过多年积累拥有优质的全球客户资源。

目前，50% 以上的世界前 20 强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为通富微电的客户。同时，业界意识到集成电路产业链自主可控的重要性及紧迫

性，也极大加快了集成电路产业国产化的进程。公司与国内知名半导体企业展开密切合作，2021 年上半年中国境内营收占总营收的比重为 28.74%，与 2020 年上半年该指标同比，上升了 8.25 个百分点；造成上述变化的主要原因是，中国境内客户订单金额的增速快于中国境外客户订单金额的增速。在此背景下，预计未来国内客户订单规模将持续提升。

公司是全球产品覆盖面最广、技术最全面的封测龙头企业之一。公司布局的存储器芯片、模拟芯片、汽车电子、功率 IC、高性能计算、5G、MCU 和显示驱动等业务，下游市场空间巨大，形成了公司独特的差异化竞争优势。

在技术方面，随着物理瓶颈的出现，摩尔定律越来越难，单纯提升制程已无法满足愈发轻薄、功能繁多的终端产品的需要，先进封装通过提升集成密度、降低整体面积、提升带宽及速度，对延续摩尔定律经济效益具有关键意义。公司凭借多年技术积累及不断研发投入，已具备了 Chiplet 封装的大规模生产能力；在 CPU、GPU、服务器领域立足 7nm，进阶 5nm，目前已实现 5nm 产品的工艺能力和认证，未来将助力 CPU 客户高端进阶；公司先进封装项目荣获“国家科学技术进步一等奖”，该项目突破了高密度高可靠电子封装技术的瓶颈制约，为我国集成电路先进封装技术高端化发展发挥了支撑引领作用。

四、公司 2021 年非公开发行股票募投项目情况

公司本次拟采用非公开发行股票方式募集不超过 55 亿元资金用于募投项目建设、补充流动资金及偿还银行贷款。五个生产型募投项目分别为存储器芯片封装测试生产线建设项目、高性能计算产品封装测试产业化项目、5G 等新一代通信用产品封装测试项目、圆片级封装类产品扩产项目、功率器件封装测试扩产项目，上述五个生产型募投项目达产后，预计每年新增营收 37.59 亿元，预计每年新增净利润 4.45 亿元。募投项目均围绕公司主营业务展开，

	产能释放后公司能够更好的抓住市场发展机遇,满足客户需求,规模优势更加突出,覆盖全面的产品布局与强大的规模化生产能力相得益彰,预计公司的市场竞争力将进一步提升。
附件清单(如有)	—
日期	2021年12月30日